

Smart Retail
Digital Signage
Interactive Kiosks
Hospitality

NEXCOM



NDiS・Neu-X・AIEdge-X series

Interactive Signage Platform Product Selection Guide

スマートリテール・サイネージソリューション
セレクトカタログ Vol.6

2024.02 | NEXCOM Japan www.nexcom-jp.com

●会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。●このカタログに記載されている内容は製品改良のため、予告なく仕様・デザイン等を変更する場合があります。●このカタログの記載内容は2024年2月現在のものです。

本製品に関するお問い合わせは



株式会社ネクスコム・ジャパン

〒108-0014 東京都港区芝4-11-5 田町ハラビル9階
TEL : 03-5419-7830 FAX : 03-5419-7832
Email : sales@nexcom-jp.com
URL : <https://www.nexcom-jp.com>

Neu-X

ラインナップ充実
低価格なスマートシティコントローラ
バリューモデルも展開中

Neu-X102-N50 p.9 Neu-X102-N97 p.9



Neu-X303mini p.11 Neu-X304 p.12



Xシリーズは、低価格を実現した産業用ファンレス・スマートシティ・コントローラです。デジタルサイネージからゲートウェイまで、インドアユースに適しています。

In-Door

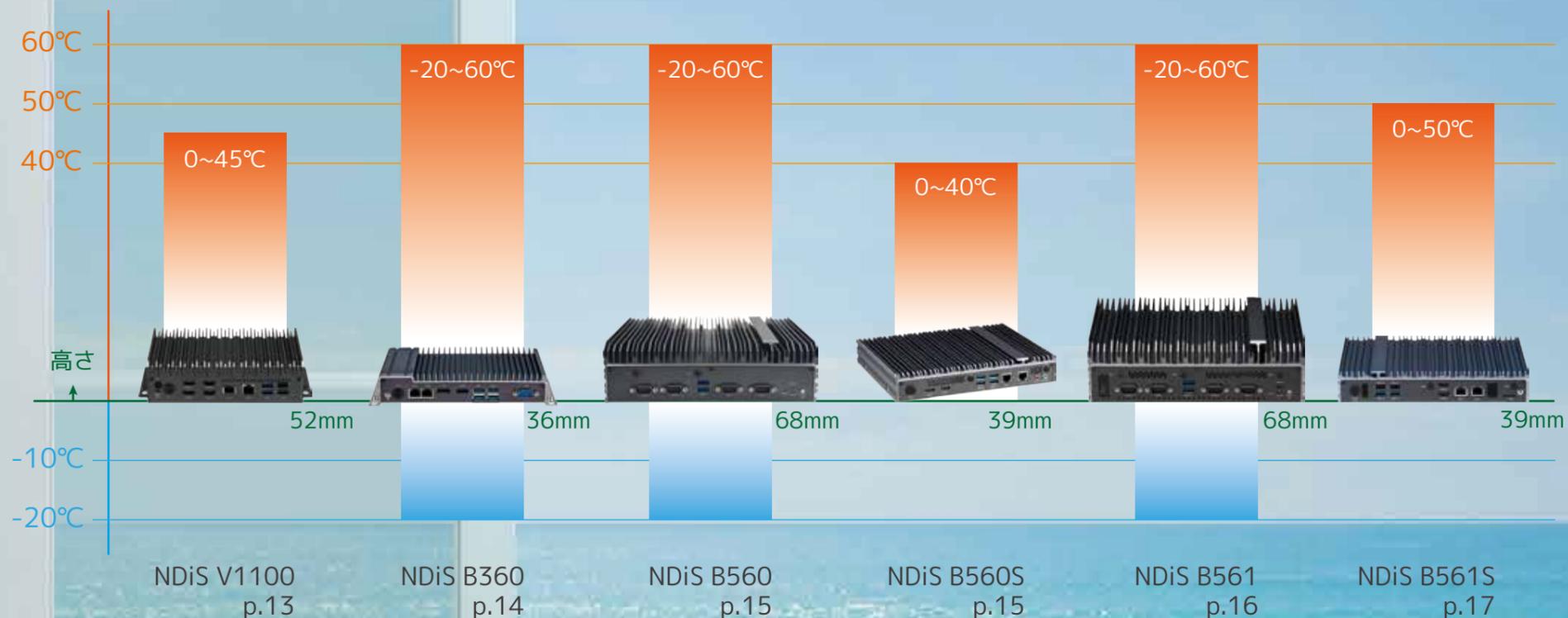
Neu-Xシリーズ
エッジコンピューティング
システム



Semi Out-Door

NDiS

ネクスコムが誇るフラグシップ高性能 STB
より信頼性の高いビジュアルソリューションを実現



NDiS V1100
p.13

NDiS B360
p.14

NDiS B560
p.15

NDiS B560S
p.15

NDiS B561
p.16

NDiS B561S
p.17

NDiS シリーズは、2009 年のデビュー以来 15 年に渡り、世界中で運用されているネクス
コムのデジタルサイネージ用 STB です。高信頼性をポリシーとし、より広い動作温度範囲
や設置しやすい薄型のボディなど、インドアはもちろんアウトドアユースにも適していま
す。駅や空港をはじめとする公共機関やリテールマーケットなど、設置環境を選びません。

AIEdge-Xシリーズ
AI エッジコンピュータ



XPPCシリーズ
タッチパネルコンピュータ



NDiS Vシリーズ
マルチディスプレイ
コンピューティングシステム



NDiS Bシリーズ
インダストリアル
ビジュアルエンジン



NEXCOM導入事例1

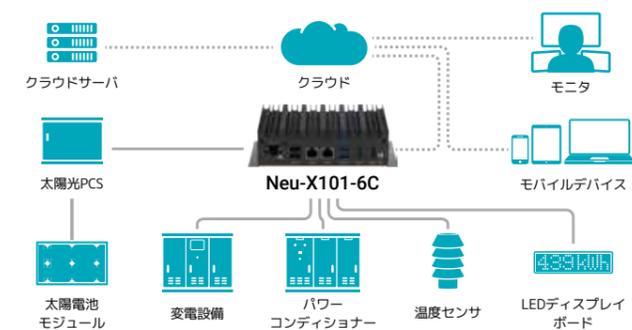
グリーンエネルギー発電における電力システムの監視と最適化

Neu-X101-6C

Neu-X101-6C 組み込みシステムによる太陽光発電システムの電力データ監視

気候変動への対策として、ネットゼロの実現に向けた世界の動きは、太陽光発電と、そのパフォーマンスを監視する電力管理システムの需要を加速させています。

太陽光発電が成長を続ける中、従来とは異なる課題が発生しています。それは、クリーンなグリーン・エネルギーと従来の送電網が供給する安定した電力とのバランスを取り、最適化することであり、太陽光発電の利用者が、電力効率を最大化できるよう管理と制御を行うことです。このような電力システムを監視するには、RS485 通信により機器から取得したデータをオンラインで送信し、リアルタイム監視とリモート管理を可能にする必要があります。



NEXCOMのクライアントは、グリーン電力管理業界で、スーパーマーケット、ドラッグストア、老人ホームなどに空調電力削減制御システムを提供し、電力消費データの詳細な分析を通じて空調電力消費を最適化しています。単に機器を接続するだけでなく、エアコン、太陽光発電、送電網への接続や監視を難しくしているのは、RS485 でデータを収集し、インターネットに接続し、システムを 24 時間 365 日オンラインに保つことです。

Neu-X101-6C は、この問題に対する NEXCOM のソリューションです。Neu-X101 を核に、Intel® Celeron® J3455 プロセッサ、マルチディスプレイ用の HDMI 出力× 2、高速インターネット接続用の GbE LAN ポート× 2、各種周辺機器用の USB ポート× 4 や、ワイヤレスモジュール拡張オプションを搭載しています。また、ホコリを寄せ付けないファンレス設計、12V DC 電源入力、-5 ~ 50° C の動作温度をサポートするなど、堅牢な仕様です。Neu-X101 ベースモデルに COM ポート× 6 を追加し、他の必要なコンポーネントを保持することで、冗長性のあるデータ収集設定が可能になりました。

Neu-X101 産業用組み込みコンピュータは、小さな設置面積と高性能を備えた信頼性の高いコンピュータシステムを、電力管理システムに提供しています。カスタマイズされた Neu-X101-6C は、複数の RS485 ポートを備えており、顧客はエネルギーデータを取得し、エネルギー使用の最適化とバランスを取るためのリアルタイム遠隔監視を行うことができます。

NEXCOM導入事例2

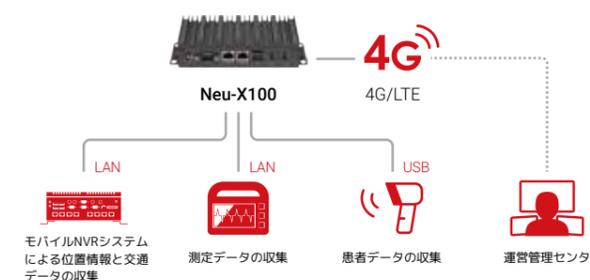
医療サービスの提供を支える IoT アプリケーション

Neu-X100

移動診療所バスの IoT ゲートウェイ

大手電子機器メーカーである NEXCOM のクライアントは、医療サービスを提供する人々のための、モバイル・ヘルス・クリニック (MHC) の設備の開発を任されていました。MHC の医療機器を、電子カルテのシステムと統合するためには、クラウドへの IoT ゲートウェイとして機能する、組み込みコンピュータが必要でした。この IoT プラットフォームは、適切なコア機能を提供し、外部機器用の I/O を備え、クラウドに接続する機能も備えている必要がありました。移動中は稼働しないため、車載用 PC ほどの耐振動・耐衝撃性は必要としていなかったことから、Neu-X100 が採用されました。

Intel® Celeron N3350/J3455 プロセッサと、最大 8GB のメモリを搭載した Neu-X100 は、安定した動作に必要な電力をバランスよく備えており、そのコンパクトなサイズは、スペースに限りのある MHC の環



境には最適な選択肢です。また、屋内環境での IoT アプリケーション向けのデザインは、MHC 内でゲートウェイとして機能する IoT プラットフォームとして最適な製品です。

この MHC に必要な主な機能は、X 線装置への接続、バーコードスキャナ、4G を通じたインターネットへのアップロードです。Neu-X100 には、医療機器から測定データを収集し、位置および交通情報を収集する NVR システムに接続する 2 つの LAN ポートがあります。周辺機器用に 2 つの USB 3.0 ポートがあり、この場合、個人カードをスキャンするためのバーコードスキャナに接続されています。また、Mini-PCIe LTE アドオンカード、SIM カードスロット、2 つのアンテナホールから接続されたアンテナにより、4G インターネット接続を提供します。

基本的なハードウェアの仕様に加え、Neu-X100 は Microsoft Azure の認証を受け、Windows 10 IoT を使用しているため、既存のシステムにシームレスに統合することができます。

Neu-X100 は、Microsoft Azure を使用した IoT ゲートウェイのセットアップに最適です。予想される負荷に十分対応できるプロセッサを搭載しながら、最小限の電力しか使用せず、ほとんどのアプリケーションに十分な周辺機器を提供します。Neu-X100 は、NEXCOM のクライアントにとってコストと性能のベストバランスを提供し、設置と統合を迅速かつシンプルに行うことができました。

NeW

2024.6

VALUE MODEL++

に登場!

Neu-X60 (仮称)



- Intel® Processor N50 (Dual Core, 最大3.4 GHz)
- Intel® UHD Graphics
- DDR4 SO-DIMM 4GB搭載済み
- M.2 64GB SSD搭載済み
- RS232/422/485 x 1, LAN x 1, USB3.2 x 2, HDMI 1.4 x 1
- Mini-PCIe スロット x 1 (LTE), Nano-SIMスロット x 1
- +12V DC / 50W ACアダプタ付属
- 動作温度範囲 0°C~40°C



手のひらサイズ

低価格、小型、必要最低限の機能を搭載した、手のひらサイズのファンレスエッジコンピューティングシステムは、デジタルサイネージ、産業用コントローラシステム、IoT ゲートウェイ、セルフサービスキオスク、屋内アプリケーション、小売機器など、ほとんどのアプリケーションをサポートします。

w.nexcom

NEXCOM導入事例3 千葉・浦安市

インタラクティブ プロジェクションマッピング NDiS B537

Interactive
Projection
Mapping



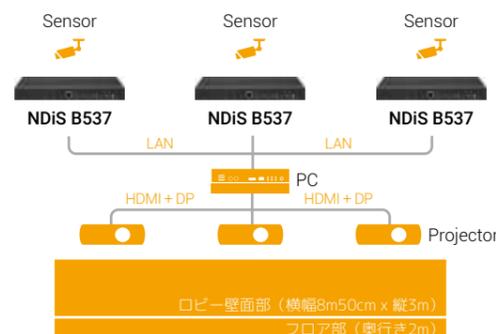
受付カウンターの混雑緩和を促進し 子供たちが楽しめる空間の提供を助ける NEXCOM の STB

世界でも有数のアミューズメントパークのパートナーホテルであるオリエンタルホテル東京ベイは、主要顧客となるファミリー層の顧客満足度の更なる向上や、受付カウンターでの混雑緩和を目指すと同時に、先進的なデザインを求めた結果、Playful Forest (プレイフルフォレスト) をコンセプトにしたロビー施設のリニューアルに伴い、国内ホテル初となる、インタラクティブプロジェクションマッピングを導入することとなりました。

導入以前は、アミューズメントパークの閉園に合わせてファミリー客が押し寄せていた受付カウンターも、子供たちや同伴のお客様が、プロジェクションマッピングのあるロビー壁面側へ流れることで、混雑が解消され、チェックイン手続きがスムーズに行えるようになり、ロビー全体が宿泊客やレストランの利用客にホテルの施設を十分楽しんでいただける場となりました。

ロビー壁面のスクリーンは、横幅約 8.5m x 高さ 3m、壁面から続くフロア部分は 2m の奥行きがあり、約 7m 手前のガゼボ(休憩施設)上に設置された 3 台のプロジェクタから、プロジェクションマッピングを投影しています。壁面上部に設置した 3 台の NEXCOM 製 STB (セットトップボックス) で受信したセンシング情報は、Ethernet でレンダリング用の PC に送られ、HDMI や DP ポートを介し、接続された 3 台のプロジェクタが、センサで捉えた人物の動きに合わせた映像を出力します。

NEXCOM のファンレス仕様の STB は、フロア部に敷かれたカーペットからの埃にも強く、容易なメンテナンスで長期間にわたって利用いただけます。また、パルコススペースシステムズ社が提供する人気のコンテンツは、特殊な動きで登場する隠れキャラもあり、子供たちに大人気で、2019 年 10 月からは第二弾となるスカイサーカスのインタラクティブプロジェクションマッピングでお客様をお迎えしています。



NDiS B537

- 第7世代 Intel® Core™ プロセッサ
- Intel® HD Graphics 630
- 2画面ディスプレイ対応 HDMI x2 ポート
- 薄型ファンレスデザイン

インタラクティブ
プロジェクション
マッピング
「スカイサーカス」



Neu-X101 シリーズ

ベストセラー Celeron® J3455 搭載で豊富なオプション 使いやすくなったスマートシティコントローラ

Neu-X101 は、Neu-X100 と同一のコンパクトサイズをで、放熱効果を高め、USB ポート x4 や、Nano サイズ SIM、オーディオ端子 (オプション)、LTE (オプション) などを追加しました。CPU は Intel® Celeron® J3455 で、さまざまな用途に導入可能なスマートシティコントローラです。



マザーボード単体
ご提供可能



Neu-X101 シリーズ共通仕様

- Intel® Celeron® J3455 (Quad Core, 1.5GHz)
- Intel® HD Graphics 500
- DDR3L SO-DIMM スロット x 1 最大 8GB
- LAN x 2, USB3.0 x 2, USB2.0 x 2
- HDMI 1.4b x 2, M.2 x 1 (SSD)

動作温度範囲 -5°C ~ 50°C



Neu-X101

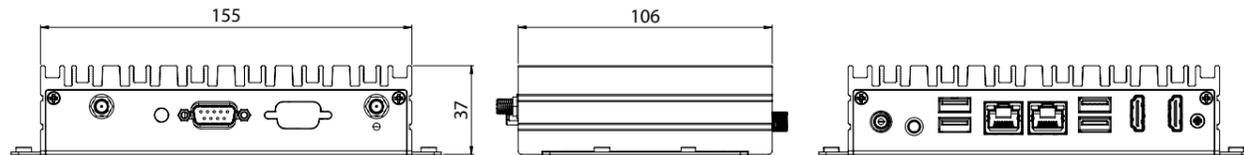
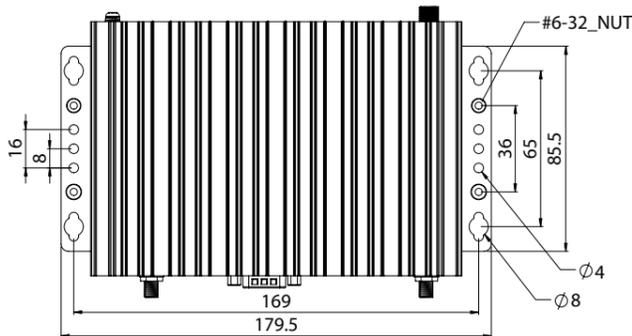


Neu-X101 背面

- Neu-X101 :
- RS232/422/485 x 1
 - Mini-PCIe スロット x 1 (LTE), Nano-SIM スロット x 1
 - ロック付き DC ジャック
+12V DC / 60W ACアダプタ付属
 - 155mm (W) x 106mm (D) x 37mm (H) 1.0 kg

Neu-X101 ハードウェア追加オプション(背面) :

- 2nd COM x 1 (RS232)
- オーディオ (Line-out)



Neu-X101-6C-DC ODM 製品

Neu-X101 をベースとした通信機能を追加 (COMx6) した ODM 製品。RS232Cx6、RS485x5 + RS232C、RS422 等、各ポートをカスタマイズ可能。DC 入力コネクタは産業向けターミナルブロックを採用し、電源供給が容易になりました。さらに 12V-24V のワイドレンジ DC 入力をサポートします。ODM 製品のため数量による縛りがありますのでお問い合わせください。



Neu-X101-6C-DC



Neu-X101-6C-DC 背面

- Neu-X101-6C-DC :
- RS232 x 1, RS485 x 4, RS232/422/485 x 1
 - 2極端子ブロック
 - 9~24V DC 入力
 - 155mm (W) x 121mm (D) x 44mm (H) 1.1 kg

Neu-X102-N50 / Neu-X102-N97

新型 Intel プロセッサ搭載 用途に合わせた 2 タイプのスマートシティコントローラ

Neu-X102 シリーズは、X101 のデザインを継承し、Intel® Processor N50、N97 CPU を搭載。低消費電力・低価格で大幅にアップグレードされました。さらに高速な CPU N97 を搭載し、放熱のための大型ヒートシンクとなり、少し前の Core i3 程度のパフォーマンスを発揮します。



マザーボード単体
ご提供可能



Neu-X102-N50



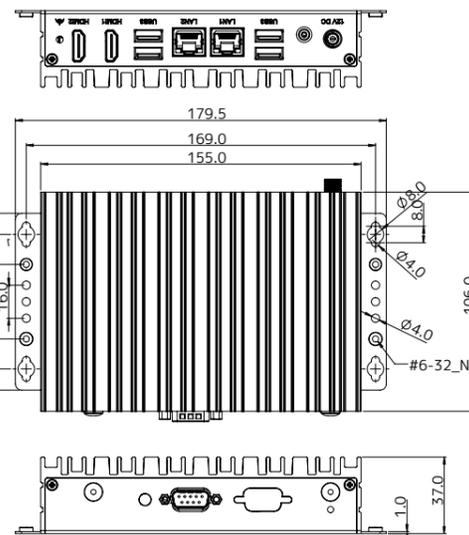
Neu-X102-N97



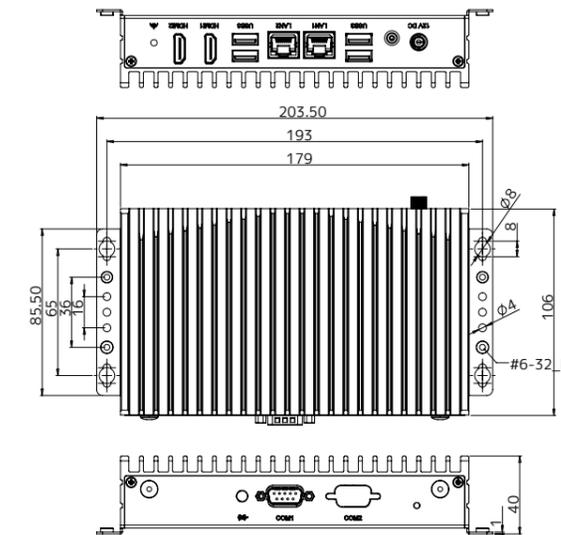
Neu-X102-N50 背面



Neu-X102-N97 背面



Neu-X102-N50 寸法



Neu-X102-N97 寸法

- Neu-X102-N50 :
- Intel® Processor N50 (Dual Core, 最大 3.4 GHz)
- Neu-X102-N97 :
- Intel® Processor N97 (Quad Core, 最大 3.6 GHz)

- Intel® UHD graphics

- DDR4 SO-DIMM スロット x 1 最大 16GB
- RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.2 x 4, HDMI 1.4b x 2
- M.2 x 1 (SSD)
- Mini-PCIe スロット x 1 (LTE), Nano-SIM スロット x 1
- +12V DC / 60W ACアダプタ付属

外形寸法 Neu-X102-N50 : 155mm (W) x 106mm (D) x 37mm (H)
外形寸法 Neu-X102-N97 : 179mm (W) x 106mm (D) x 40mm (H)

重量 0.85 kg
重量 0.9 kg

動作温度範囲 -5°C ~ 50°C

Neu-X300-H310

第 8/9 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応スマートシティコントローラ

Neu-X300 シリーズは、デジタルサイネージのみならず、様々な目的に使用可能なハイパフォーマンスなスマートシティコントローラです。ソケットタイプの第 8 世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載可能。Core™ i7 から Celeron® まで目的に合わせて選択いただけます。

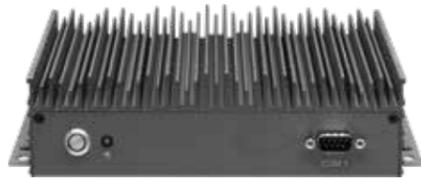


マザーボード単体
ご提供可能



Neu-X300-H310

CPUタイプ：
第8/9世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)
搭載可能CPU：
Core i3-8100T (4 Core, 3.1GHz)
Core i5-8500T (6 Core, 2.1GHz)
Core i7-8700T (6 Core, 2.4GHz)



Neu-X300 背面

- Intel® H310, Intel® UHD Graphics 630
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.0 x 4

- HDMI2.0 x 2, Audio-out x 1
- M.2 x 1 (SSD)
- +12V DC / 96W ACアダプタ付属

外形寸法 190mm (W) x 200mm (D) x 55mm (H)

重量 2.6 kg

動作温度範囲 -5°C ~ 45°C

Neu-X302-H

第 8/9 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 COMx6 レガシーなシステムやインダストリアルに

Neu-X302-H は、第 8/9 世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載しながら、COM x6、Mic と分割したオーディオポート、レガシーな VGA ポートを備えました。また 2.5 インチ HDD の選択など、旧型のコントローラからの置き換えとして十分に活用いただける、新旧の性能を持ち合わせたコントローラです。



マザーボード単体
ご提供可能



Neu-X302-H

CPUタイプ：
第8/9世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)
搭載可能CPU：
Core i3-8100T (4 Core, 3.1GHz)
Core i5-8500T (6 Core, 2.1GHz)
Core i7-8700T (6 Core, 2.4GHz)



Neu-X302-H 背面

- Intel® H310, Intel® UHD Graphics 630
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232 x 3, RS232/422/485 x 3, LAN x 2, USB3.0 x 4
- HDMI x 1, VGA x 1, Line-out x 1, Mic x 1

- 2.5インチベイ x 1
- M.2 x 1 (LTE/SSD 排他的使用)
- SIMスロット x 1
- +12V DC / 96W ACアダプタ付属

外形寸法 190mm (W) x 200mm (D) x 65mm (H)

重量 2.7 kg

動作温度範囲 -5°C ~ 45°C

Neu-X303

第 12 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応スマートシティコントローラ

SoC でソケットタイプ、第 12 世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載した Neu-X303 シリーズのエッジコンピューティングシステムは、非常にリッチなマルチメディアコンテンツや AI 処理を扱うことができます。Intel® Iris® Xe グラフィックスによる強力なグラフィックスは、4K の再生やコンテンツ制作など圧倒的なグラフィックを提供します。



マザーボード単体
ご提供可能



Neu-X303

CPUタイプ：
第12世代 Intel® Core™ プロセッサ (15W)
搭載可能CPU：
i3-1215UL (6 Core 2P4E, 8スレッド)
i5-1235UL (10 Core 2P8E, 12スレッド)
i5-1245UL (10 Core 2P8E, 12スレッド)
i7-1255UL (10 Core 2P8E, 12スレッド)
i7-1265UL (10 Core 2P8E, 12スレッド)



Neu-X303 背面

- Intel® UHD Graphics / Intel® Iris® Xe Graphics
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2 最大64GB
- LAN x 2, USB3.2 x 4

- HDMI2.1 x 1, DisplayPort x 1, USB type-C x 2 (ビデオ出力)
- M.2 x 1 (SSD), M.2 x 1 (Wi-Fi)
- +12V DC / 120W ACアダプタ付属

外形寸法 190mm (W) x 150mm (D) x 60mm (H)

重量 1.9 kg

動作温度範囲 0 ~ 50°C

Neu-X303mini

第 12 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 コンパクトなエッジコンピューティングシステム

次世代プロセッサを搭載可能な Neu-X303mini は、AI 処理をはじめ、USB、Type-C ポート x2 を含む豊富な I/O を備えたコンパクトなエッジコンピューティングシステムで、高度なグラフィック処理や AI を駆使したアプリケーション等、ビジュアル・エッジ・コンピューターとしても理想的です。



マザーボード単体
ご提供可能



Neu-X303mini

CPUタイプ：
第12世代 Intel® Core™ プロセッサ (45W)
搭載可能CPU：
i3-12300HL (8 Core 4P4E, 12スレッド)
i5-12500HL (12 Core 4P8E, 16スレッド)
i5-12600HL (12 Core 4P8E, 16スレッド)
i7-12700HL (14 Core 6P8E, 20スレッド)
i7-12800HL (14 Core 6P8E, 20スレッド)



Neu-X303mini 背面

- Intel® UHD Graphics / Intel® Iris® Xe Graphics
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2 最大64GB
- LAN x 2, USB3.2 x 4

- HDMI2.1 x 1, DisplayPort x 1, USB type-C x 2 (ビデオ出力)
- M.2 x 1 (SSD), M.2 x 1 (Wi-Fi)
- +12V DC / 120W ACアダプタ付属

外形寸法 183mm (W) x 138mm (D) x 48mm (H)

重量 1.5 kg

動作温度範囲 0 ~ 60°C

Neu-X304-H610

IoT エッジ向け第 12/13 世代 Intel プロセッサ搭載

新型 CPU を搭載可能な Neu-X304 システムは、新時代の AI とビジュアルエッジコンピューティングの性能と効率の融合を提供し、ヘルスケアサービス、公共交通機関の監視、デジタル教育システム、AI 認識、データセンター・クラウドコンピューティングなど、産業における多目的なアプリケーションをサポートします。



マザーボード単体
ご提供可能



Neu-X304-H610

CPUタイプ：
第12/13世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)
搭載可能CPU：
Core i3-12100TE (4 Core 4P0E, 8スレッド)
Core i5-12500TE (6 Core 6P0E, 12スレッド)
Core i7-12700TE (12 Core 8P4E, 20スレッド)
Core i9-12900TE (16 Core 8P8E, 24スレッド)



Neu-X304-H610 背面

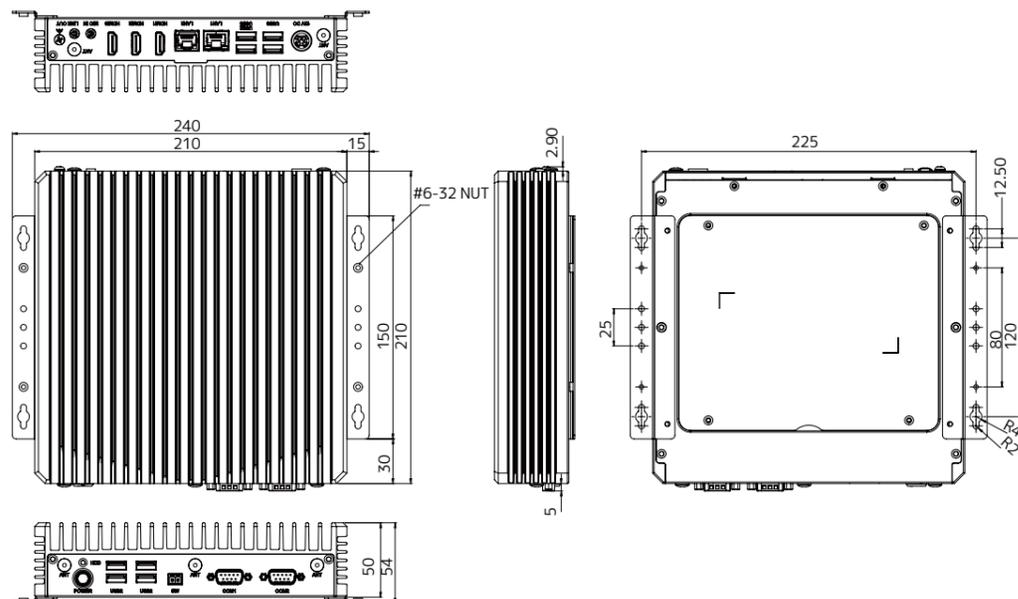
- Intel® PCH H610E
- Intel® UHD Graphics 730 / Intel® UHD Graphics 770
- DDR5 SO-DIMMスロット x 2 最大64GB
- RS232 x 1, RS232/422/485 x 1, LAN x 2
- USB3.2 x 3, USB2.0 x 5

- HDMI 2.0 x 3, LVDS x 1, Line-out x 1, Mic x 1
- M.2 x 1 (SSD)
- M.2 x 1 (LTE), Micro-SIMスロット x 1, M.2 x 1 (Wi-Fi)
- リモートスイッチ端子 x 1
- +12V DC / 120W ACアダプタ付属

外形寸法 210mm (W) x 210mm (D) x 50mm (H)

重量 2.6 kg

動作温度範囲 -5°C ~ 45°C



NDiS V1100

第 11 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4X マルチディスプレイシステム

NDiS V1100 は、高性能でハイコストパフォーマンスな第 11 世代 Intel® Core™ i3/i5 プロセッサを搭載し、高性能な 4 画面グラフィックスとマルチメディア処理を実現しました。4 ポートの HDMI によりインパクトのある多彩な表現が可能です。



NDiS V1100

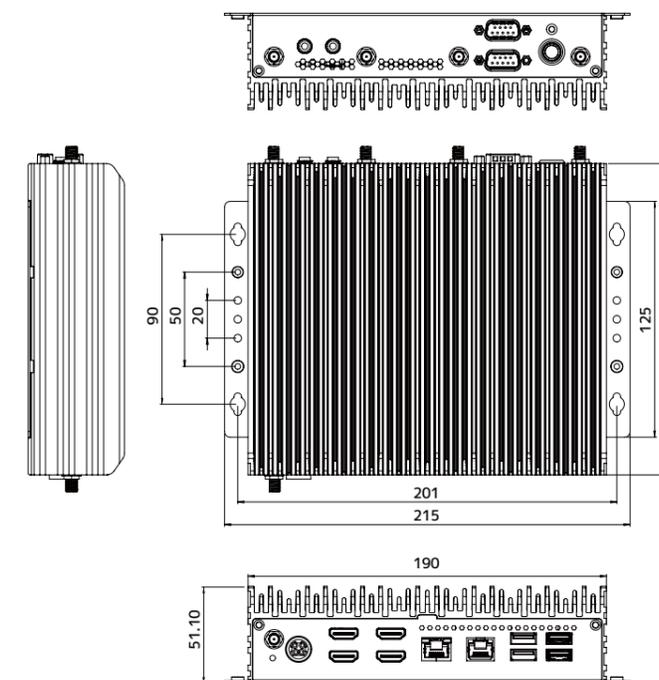
- NDiS V1100-i3：
Intel® Core™ i3-1115G4E (Dual Core, 2.2 GHz)
- NDiS V1100-i5：
Intel® Core™ i5-1145G7E (Quad Core, 1.5 GHz)
- Intel® UHD Graphics / Intel® Iris® Xe Graphics
 - DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大64GB

- RS232 x 1, RS232/422/485 x 1, LAN x 2
- USB3.0 x 3, USB2.0 x 1
- HDMI x 4
- M.2 x 1 (SSD)
- Mini-PCIe スロット x 1 (LTE), Nano-SIMスロット x 1
- M.2 x 1 (Wi-Fi)
- +12V DC / 96W ACアダプタ付属

外形寸法 190mm (W) x 165mm (D) x 52mm (H)

重量 2.6 kg

動作温度範囲 0°C ~ 45°C



NDiS V1100 背面

NDiS B360 / NDiS B360-DC

第 11 世代 Intel® 新型 Core™ プロセッサ搭載 TDP 15W / 10nm でより軽やかな動作性能

NDiS B360 は、第 11 世代 Intel® Core™ i3-1115G4E または Core™ i5-1145G7E プロセッサをオンボードで搭載した STB です。10 nm SuperFin により、グラフィック性能も一段とレベルアップし、Core i3 でも Celeron J3455 の約 3 倍の CPU パワーを有します。



NDiS B360

NDiS B360 :
 ・ RS232 x 1, RS232/422/485 x 1
 ・ DC ジャック
 ・ +12V DC / 60W ACアダプタ付属
 ・ 200mm (W) x 133mm(D) x 36mm (H) 1.3 kg



NDiS B360 背面



NDiS B360-DC

NDiS B360-DC :
 ・ RS232 x 1
 ・ 3極端子ブロック
 ・ 24V DC入力 (ACアダプタ付属なし)
 ・ 200mm (W) x 133mm(D) x 36mm (H) 1.2 kg



NDiS B360-DC 背面

NDiS B360 シリーズ共通仕様

NDiS B360-i3 :
 Intel® Core™ i3-1115G4E (Dual Core, 2.2GHz)
 Intel® UHD Graphics
NDiS B360-i5 :
 Intel® Core™ i5-1145G7E (Quad Core, 1.5GHz)
 Intel® Iris® Xe Graphics

・ DDR4 SO-DIMM スロット x 1 最大32GB
 ・ LAN x 2, USB3.0 x 4
 ・ HDMI2.0 x 1, DisplayPort++ x 1, Line-out x 1
 ・ M.2 x 1 (SSD)
 ・ M.2 x 1 (Wi-Fi)

外形寸法 200mm (W) x 133mm(D) x 36mm (H)

重量 1.3 kg

動作温度範囲 NDiS B360 : -20°C ~ 60°C

動作温度範囲 NDiS B360-DC : 0°C ~ 40°C

NDiS B560

第 8/9 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 広温度対応 屋外のデジタルサイネージやキオスク機器向け 

NDiS B560 は -20°C ~ 60°C に対応するデジタルサイネージ STB です。COM x4、HDMI x3 を搭載しており、屋外設置の高性能デジタルサイネージ STB としても、また豊富な COM ポートにより、キオスクや POS レジのコントローラとしても使用可能です。



NDiS B560

CPUタイプ :
 第8/9世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)
 搭載可能CPU :
 Core i3-8100T (4 Core, 3.1GHz)
 Core i5-8500T (6 Core, 2.1GHz)
 Core i7-8700T (6 Core, 2.4GHz)



NDiS B560 背面

・ Intel® Q370
 ・ Intel® UHD Graphics 630
 ・ DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB (1スロット最大16GB)
 ・ RS232 x 3, RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.0 x 6

・ HDMI x 3, Line-out x 1, Mic x 1
 ・ 2.5インチベイ x 1, M.2 x 1 (SSD)
 ・ M.2 x 1 (LTE), SIMスロット x 1
 ・ +12V DC / 96W ACアダプタ付属

外形寸法 238mm (W) x 192mm (D) x 68mm (H)

重量 3.5 kg

動作温度範囲 -20°C ~ 60°C

NDiS B560S

第 8/9 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 スリム型のデジタルサイネージやキオスク機器向け 

NDiS B560S は、NDiS B560 と同じマザーボードにバリューなチップセットを搭載し、低価格を実現しました。スリムケースに変更したことにより、使用温度範囲は 0°C ~ 40°C と狭くなりますが、設置性に優れ、薄型を好むデジタルサイネージ STB 設置環境の要求を満たしています。



NDiS B560S

CPUタイプ :
 第8/9世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)
 搭載可能CPU :
 Core i3-8100T (4 Core, 3.1GHz)
 Core i5-8500T (6 Core, 2.1GHz)
 Core i7-8700T (6 Core, 2.4GHz)



NDiS B560S 背面

・ Intel® H310
 ・ Intel® UHD Graphics 630
 ・ DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB (1スロット最大16GB)
 ・ RS232 x 3, RS232/422/485 x 1, LAN x 2

・ USB3.0 x 4, USB2.0 x 2, HDMI x 2, Line-out x 1, Mic x 1
 ・ 2.5インチベイ x 1, M.2 x 1 (SSD)
 ・ M.2 x 1 (LTE), SIMスロット x 1
 ・ +12V DC / 96W ACアダプタ付属

外形寸法 238mm (W) x 192mm(D) x 39mm (H)

重量 2.3 kg

動作温度範囲 0°C ~ 40°C

NDiS B561 / NDiS B561-PoE

第12世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 広温度対応 屋外のデジタルサイネージやキオスク機器向け



NDiS B561 ファンレス・ビジュアル・エッジ・コンピュータは、強力なマルチメディア・コンテンツを扱うことができ、-20～60℃の幅広い動作温度範囲に対応します。3つの独立ディスプレイ出力で最大 8K@60Hz の出力が可能で、豊富な接続機能を備えています。PoE ポート x2 を含む LAN ポート x3 の NDiS B561-PoE (動作温度範囲 0℃～40℃) もラインナップしました。



NDiS B561

CPUタイプ：
第12世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)
搭載可能CPU：
Core i3-12100TE (4 Core 4P0E, 8スレッド)
Core i5-12500TE (6 Core 6P0E, 12スレッド)
Core i7-12700TE (12 Core 8P4E, 20スレッド)

NDiS B561 :
• LAN x 3
• +12~24V DC入力
• 12V DC / 120W ACアダプタ付属

NDiS B561-PoE :
• LAN x 1, LAN (PoE) x 2
• 24V DC入力
• 24V DC / 180W ACアダプタ付属

- Intel® Q670E
- Intel® UHD Graphics 730 / Intel® UHD Graphics 770
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2 最大64GB (1スロット最大32GB)
- RS232 x 3, RS232/422/485 x 1, USB3.2 x 8

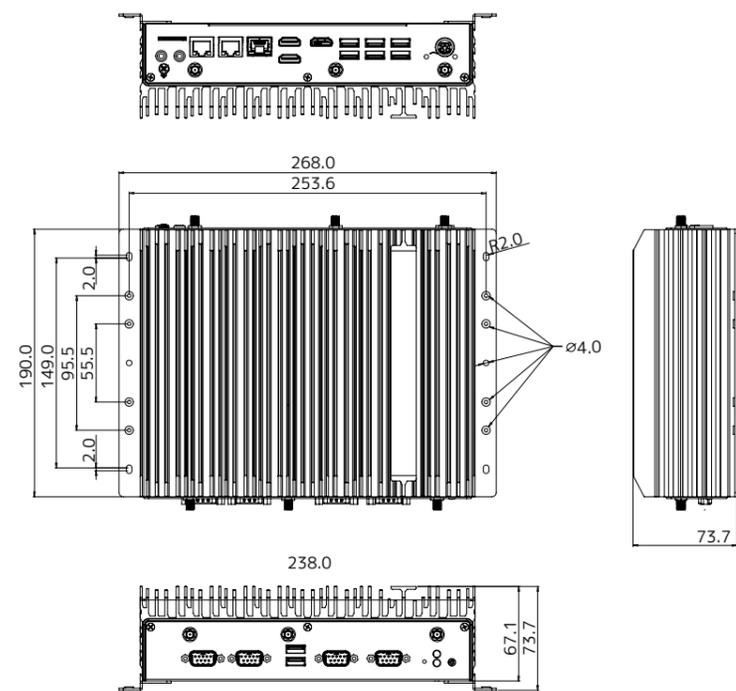
- HDMI2.0 x 2, HDMI2.1 x 1, Line-out x 1, Mic x 1
- M.2 x 2 (SSD)
- M.2 x 1 (LTE), SIMスロット x 1
- M.2 x 1 (Wi-Fi)

外形寸法 238mm (W) x 190mm (D) x 68mm (H)

重量 4.0kg

動作温度範囲 NDiS B561 : -20℃～60℃

動作温度範囲 NDiS B561-PoE : 0℃～40℃



NDiS B561 背面

NDiS B561S

第12世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 スリム型のデジタルサイネージやキオスク機器向け



NDiS B561S は、NDiS B561 と同じマザーボードにバリューなチップセットを搭載し、低価格を実現しました。スリムケースに変更したことにより、使用温度範囲は 0℃～50℃と狭くなりますが、設置性に優れ、薄型を好むデジタルサイネージ STB 設置環境の要求を満たしています。



NDiS B561S

CPUタイプ：
第12世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)
搭載可能CPU：
Core i3-12100TE (4 Core 4P0E, 8スレッド)
Core i5-12500TE (6 Core 6P0E, 12スレッド)
Core i7-12700TE (12 Core 8P4E, 20スレッド)

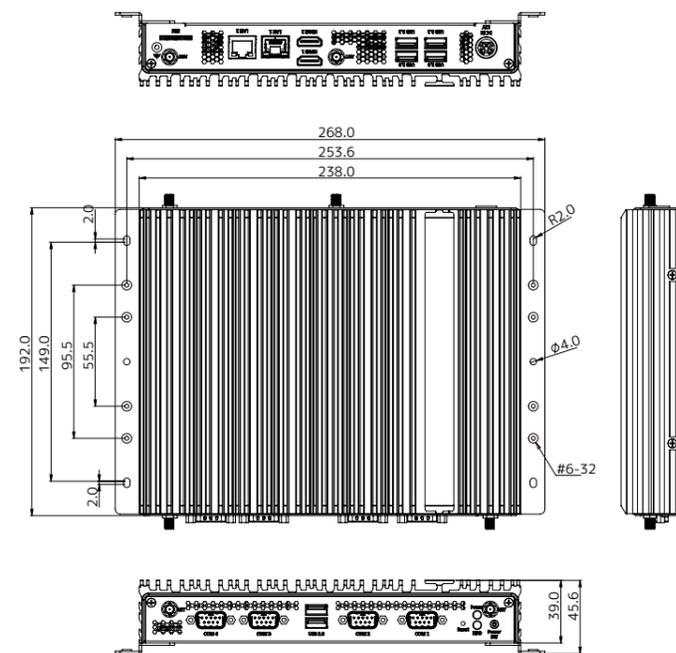
- Intel® H610E
- Intel® UHD Graphics 730 / Intel® UHD Graphics 770
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2 最大64GB (1スロット最大32GB)
- RS232 x 3, RS232/422/485 x 1, LAN x 2

- USB3.2 x 2, USB2.0 x 4, HDMI2.0 x 2
- M.2 x 2 (SSD)
- M.2 x 1 (LTE), SIMスロット x 1, M.2 x 1 (Wi-Fi)
- +12V DC / 120W ACアダプタ付属

外形寸法 238mm (W) x 190mm(D) x 39mm (H)

重量 3.0 kg

動作温度範囲 0℃～50℃



NDiS B561S 背面

AIEdge-X80

NVIDIA® Jetson Orin™ NX SoM 搭載

NVIDIA



ディープラーニングとビジョンアクセラレータ用の NVIDIA Ampere アーキテクチャ GPU で、複数の AI アプリケーションパイプラインをサポートできる AIEdge-X80 は、ファンレスのエッジ AI コンピュータで、最大 100TOPS の AI 推論アクセラレーション性能を約束します。

Coming Soon



AIEdge-X80



NVIDIA® Jetson Orin™ NX 8GB, 70TOPS, 8GB LPDDR5
NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB, 100TOPS, 16GB LPDDR5

- 1024-core NVIDIA Ampere GPU (32 Tensor Cores)
- RS232 x 1, RS232/422/485 x 1, LAN x 4
- USB3.2 x 2, USB2.0 x 2, USB OTG x 1

- HDMI1.4 x 1
- M.2 x 1 (SSD)
- M.2 x 1 (LTE), Nano-SIMスロット x 1
- Mini-PCIeスロット x 1
- 3極端子ブロック +24V DC入力

外形寸法 210mm (W) x 155mm (D) x 54mm (H)

重量 TBC

動作温度範囲 -20 ~ 70°C

AIEdge-X338

Intel® Celeron® J6412 プロセッサ搭載

Hailo-8



AIEdge-X338 は、Intel® Celeron® J6412 プロセッサと、Hailo 8™ M.2 PCIe 高性能 AI アクセラレータモジュールを搭載し、最大 26TOPS の高効率をサポートします。新たなソリューションとしての、次世代小型 AI コントローラです。



AIEdge-X338



- Intel® Celeron® J6412 プロセッサ
- Intel® UHD Graphics
- Hailo-8™ M.2 AI アクセラレーションモジュール, 26TOPS
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232 x 2, LAN x 1

- USB3.2 x 1, USB2.0 x 5
- HDMI1.4 x 2, Line-out x 1, Mic x 1
- M.2 x 1 (SSD)
- Mini-PCIeスロット (LTE) x 1, SIMスロット x 1
- +12V AC/DC / 60W アダプタ付属

外形寸法 224mm (W) x 150mm (D) x 40mm (H)

重量 TBC

動作温度範囲 -20 ~ 70°C

AIEdge-X300 / AIEdge-X300-RTX

第8/9世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 大型 GPU を搭載可能な2タイプ



AIEdge-X300 は Neu-X300 と同じマザーボードを採用、ファン付きソリューションとして、GeForce などの GPU を取り付けるための拡張スロットを装備しています。本格的な AI 処理やディープラーニング、マルチ画面のデジタルサイネージ用 STB として使用可能です。AIEdge-X300-RTX は、本体の奥行きが 6cm 長い仕様です。

CPUタイプ：
第8/9世代 Intel® Core™ プロセッサ
搭載可能CPU：
Core i3-8100T (4 Core, 3.1GHz, 35W)
Core i5-8500T (6 Core, 2.1GHz, 35W)
Core i7-8700T (6 Core, 2.4GHz, 35W)
Core i3-8300 (4 Core, 3.7GHz, 65W)
Core i5-8500 (6 Core, 3.0GHz, 65W)
Core i7-8700 (6 Core, 3.2GHz, 65W)



AIEdge-X300/AIEdge-X300-RTXの比較

	AIEdge-X300	AIEdge-X300-RTX
奥行き(mm)	250	310
電源(W)	500	850
対応NVIDIA GPU	RTX2060まで	RTX3090まで



- Intel® Q370 / Intel® UHD Graphics 630
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232 x 1, RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.0 x 4
- HDMI x 3, Line-out x 1

- 2.5インチベイ x 1, M.2 x 1 (SSD),
- PCIe(x16) スロット x 1
- 100V AC / 500W (AIEdge-X300-RTXは850W)

外形寸法 AIEdge-X300 : 360mm (W) x 250mm (D) x 85mm (H)

重量 4.5 kg

動作温度範囲 0°C ~ 45°C

外形寸法 AIEdge-X300-RTX : 360mm (W) x 310mm (D) x 85mm (H)

重量 5.2 kg

AIEdge-X500

第8/9世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 複数のストレージ&大型 GPU を搭載可能なハイエンドタイプ



AIEdge-X500 は、複数の PCI スロット、2.5 インチベイ x4 を搭載、ハイエンドな AI コントローラやディープラーニングマシンに適しています。効率の良い冷却ファンにより、高性能 GPU や複数の拡張カード、SSD を同時に使用できます。AI 処理プラスαのさらにクリティカルなハイエンドコンピューティングが可能です。

CPUタイプ：
第8/9世代 Intel® Core™ プロセッサ
搭載可能CPU：
Core i3-8300 (4 Core, 3.7GHz, 65W)
Core i5-8500 (6 Core, 3.0GHz, 65W)
Core i7-8700 (6 Core, 3.2GHz, 65W)



- Intel® Q370 / Intel® UHD Graphics 630
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.0 x 2, USB2.0 x 1

- HDMI x 1, 2.5インチベイ x 4, M.2 x 1 (SSD)
- PCIe(x16) スロット x 1, PCIe(x4) スロット x 1
- PCI スロット x 1, 100V AC / 800W

外形寸法 290mm (W) x 360mm (D) x 150mm (H)

重量 7.6 kg

動作温度範囲 0 ~ 45°C

リテール向け産業用グレードタッチパネルコンピュータ XPPC シリーズ

XPPC100シリーズ

Neu-X100 スマートシティコントローラの本体の一部を、液晶パネルの背面に取り付けた、エントリーレベルの低価格なファンレス静電容量 (P-CAP) タッチパネル PC です。CPU は Quad Core Celeron® J3455 を搭載、最大 8GB のメモリにより、端末機としては十分なパフォーマンスを発揮します。

XPPC200シリーズ

NDiS B360 のマザーボード、液晶パネルの背面に取り付けた、高性能なファンレス静電容量 (P-CAP) タッチパネル PC です。第 11 世代 Intel® Core™ i3 と Core™ i5 が選択可能です。他の仕様は 100 シリーズと同じです。

XPPC100シリーズの特徴

- Intel® Celeron® J3455
- Intel® HD Graphics
- DDR3L SO-DIMM スロット x 1
- M.2 x 1 (SSD SATA)
- HDMI x 1, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2 (XPPC16-101のみ)
- LTE 対応 (Mini-PCIe スロット x 1), SIMスロット x 1
- XPPC10-100: 12V DC 入力
- XPPC16-101: 19V DC 入力



XPPC10-100

10.1 インチ 16 : 10 1280 x 800
261mm (W) x 179mm (D) x 45mm (H) 2.0 kg
VESA マウント : 75mm x 75mm



XPPC16-101

15.6 インチ 16 : 9 1920 x 1080
383mm (W) x 252mm (D) x 52mm (H) 3.0 kg
VESA マウント : 100mm x 100mm



XPPC10-200

10.1 インチ 16 : 10 1280 x 800
261mm (W) x 179mm (D) x 51mm (H) 2.0 kg
VESA マウント : 75mm x 75mm



XPPC16-200

15.6 インチ 16 : 9 1920 x 1080
383mm (W) x 252mm (D) x 52mm (H) 3.0 kg
VESA マウント : 100mm x 100mm



XPPC22-100A

21.5 インチ 16 : 9 1920 x 1080
521mm (W) x 316mm (D) x 54mm (H) 5.0 kg
VESA マウント : 100mm x 100mm



XPPC24-100A

23.8 インチ 16 : 9 1920 x 1080
558mm (W) x 337mm (D) x 56mm (H) 6.0 kg
VESA マウント : 100mm x 100mm



XPPC22-200

21.5 インチ 16 : 9 1920 x 1080
521mm (W) x 316mm (D) x 54mm (H) TBC kg
VESA マウント : 100mm x 100mm



XPPC24-200A

23.8 インチ 16 : 9 1920 x 1080
557mm (W) x 337mm (D) x 55mm (H) 5.8 kg
VESA マウント : 100mm x 100mm

XPPCシリーズ共通仕様

マルチタッチ10点 投影型静電容量方式 (P-CAP)
Line-out x 1, LAN x 2, RS232/422/485 x 1
温度条件 (動作時) : 0°C ~ 50°C
防塵防滴規格 IP65準拠 (フロント部のみ)
ACアダプタ, ACパワーコード付属

背面には VESA マウントスクリーホールや専用の取付金具を使用して、壁や機器などに固定することができます。LAN x2 ポートを使用し、安定した高速通信が可能です。またフロント部分は IP65 に対応し、防水対策も施しています。

選べる3つのマウント方式

- VESA マウントによる取付け (ネジ M4x8 x4 (お客様にてご用意ください))
- オープンフレームブラケットによる取付け (別売 取付けキット)
- パネルマウントクランプによる取付け (別売 取付けキット)



※写真は XPPC10-100 です

XPPC200シリーズの特徴

- 第 11 世代 Intel® Core™ i3-1115G4E
- Intel® UHD graphics 630
- DDR4 SO-DIMM スロット x 1
- M.2 x 1 (SSD NVMe), M.2 2230 x 1 (Wi-Fi)
- HDMI x 1, DisplayPort++ x 1, USB 3.0 x 4
- 12V DC 入力

充実の国内向けサポートメニュー

ミニマムロットは1台から 1台より受注

最低発注数は、システム1台より承ります。

信頼性を高めます 出荷前検査の実施

出荷前にエージングテスト、負荷テスト等を実施します。貴社ご指定の検査や評価レポートの添付などにも対応します。

面倒な組立てはお任せ アセンブリサービス

ご希望のCPU、メモリ、ストレージ、拡張カードなど、各種アセンブリサービスもお任せ下さい。

安心の国内サポート 修理・技術サポート

修理や技術サポートを実施します。修理レポートの作成など、国内でのサポート体制を整えています。

各種キitting インストール・キitting

ご希望のOS・アプリケーションのインストール、ご指定のCDなどの添付品の同梱等、各種キitting作業も承ります。

貸出無料 評価機貸出

ネクコムの製品を無料にてお貸出しします。導入前のパフォーマンスの確認や評価にご利用ください。

修理サポートサービス

18ヶ月間の無償修理保証(標準保証)

標準品は弊社発送日より18ヶ月間の無償修理保証が添付されています。(保証書を発行しない出荷履歴管理システムにより、出荷商品の詳細は弊社で管理しております)

国内での修理対応

ネクコム・ジャパンにて修理が可能な場合は、国内修理により短期間にて返却します。

センドバックによる受付

修理品を弊社まで発送頂き、弊社にて不良状況の確認・解析・修理を実施します。

本社(NEXCOM International)での修理対応

ネクコム・ジャパンにて修理が不可能な場合は、本社のRMAセンターへ発送します。

その他オプションサービス

最長5年延長保証のオプションサポート ワランティプログラム

ネクコム・ジャパン ワランティプログラムは、NDiSシリーズ等の弊社製品をシステムで購入いただいた際に、所定の費用を購入時、お支払いいただくことにより、最長5年間修理費用が無償になるプログラムです。

※詳細は別紙ワランティ規定をご覧ください。

何回でも修理費無料!

年8%とリーズナブル

2,3,4,5年間の選択可

1台から対応

標準保証 18か月 + 延長保証(オプション)

最大5年間

安心の
延長保証

USBでメモリブートし、簡単リカバリ リカバリ USB メモリ添付サービス

パラゴンライト
新登場

製品を購入時にリカバリ USB メモリ添付サービスをオプションにてご利用頂けます。出荷時に Windows イメージ USB メモリにリカバリして添付しますので、障害発生時に出荷時の状態に簡単に復旧することができます。また、お客様のアプリケーション等を含めたオリジナルのリカバリイメージを何回でも作成可能です。お客様でイメージを作成するパラゴンライト(USBメモリとパラゴンソフトウェアのみ)も低価格でご用意しています。(※ Windows OS のみ対応となります。日本語版が標準ですが、英語版も対応可能です。)



【USBリカバリの資料】
NEXCOM テクニカルサポートページ
カタログ・マニュアルダウンロード



カラーチェンジやインターフェースのカスタマイズ ステッカー製作などオリジナルブランド品の制作をお手伝い

ODMソリューションその① キittingサービス

Windows や Linux や貴社専用のアプリケーションのインストールなど各種キittingサービスを行います。貴社での面倒なインストール作業を削減し、到着したその日からすぐにお使い頂けます。

ODMソリューションその② ソフトのカスタマイズ

BIOS のカスタマイズ(ロゴ表示・デフォルト値の変更)や WindowsOS のイメージ作成・構築をはじめ各種アプリケーション開発のお手伝いも可能です。詳しくは弊社営業部までご相談下さい。弊社パートナーをご紹介させて頂きます。

ODMソリューションその③ パネルのステッカー製作

ステッカーの製作は200枚から承ります。ステッカーを弊社でお預かりし、本体ご注文時に貼り付けて出荷致します。

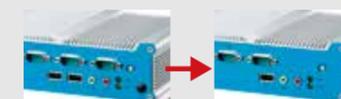


ODMソリューションその④ カラーチェンジ

ケースのカラーチェンジは200台ロットより対応致します。また社名やロゴ、インターフェース名の変更も可能です。

ODMソリューションその⑤ ボードのカスタマイズ

ボード上のコンポーネントの取外しや変更など、I/O や機能のカスタマイズが可能です。



ODMソリューションその⑥ 各種認証取得

標準にて CE と FCC 認証を取得していますが、ご希望に合わせて、VCCI や UL、CCC などの取得手続きを別途行います。

ネクコム・ジャパンオリジナル ネクコム IoT ソリューション

LTE通信内蔵対応、モバイルネットワークで 遠隔制御・稼働監視・遠隔保守・メンテナンスを実現

LTE モジュール

SIMCom Wireless Solution社製



SIM7600JC-H-MPCleモジュール

対応回線	docomo/au/Softbank
アクセス方式	FDD-LTE
ダウンロード	最大150Mbps (FDD-LTE)
アップリンク	最大50Mbps (FDD-LTE)
動作温度	-30~80°C



SIM7600JC-H-M2モジュール

型式名	docomo/au/Softbank
アクセス方式	FDD-LTE
ダウンロード	最大150Mbps (FDD-LTE)
アップリンク	最大50Mbps (FDD-LTE)
動作温度	-30~80°C

LTE 通信専用アンテナ



メーカー	キャセイ・トライテック	
品名	1 ダイポールアンテナ	2 無指向性アンテナ
型名	JSK-4G-401	CTA-002-2m
外形寸法 (mm)	-	-
ケーブル長 (m)	-	2
動作温度	-40~70°C	
取付方法	本体に直付け	両面テープ